

提高無粗化銅箔與高頻低損失基板抗撕強度的底漆層技術

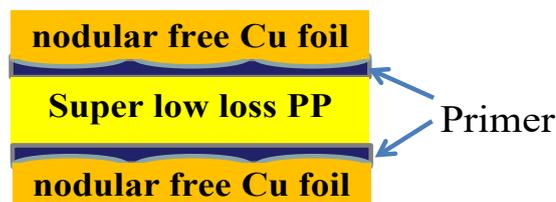
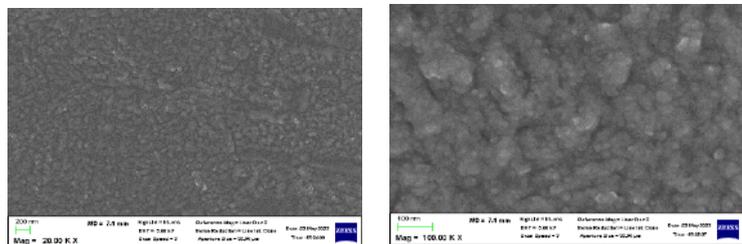
技術簡介

為了降低高頻傳輸損耗需使用超低粗糙度銅箔降低導體損耗及低極性樹脂的基板材料降低介電損耗，由於兩材料間的接著性極差，需要一層底漆層(primer)，在不影響基板電性的前提下，提升兩者間的抗撕強度。

技術特色

- 銅箔Rz~1 μ m
- 無粗化銅瘤
- 底漆層厚度 $\leq 6\mu$ m
- 具優良電性
- 有效提高抗撕強度

Nodular free Cu foil



技術成果

Sample	介電性質 (10GHz)		Peel strength (kg/cm)		288°C dip 5 min (5*5cm)
	Dk	Df	常態	288°C漂錫 10秒5次	
銅箔+ PP	2.9	0.002	0.33	0.32	pass
銅箔+ primer + PP	2.9	0.002	0.90	0.88	pass

註：1. 介電性質是壓合後將銅全板蝕刻後測值

應用對象

銅箔廠或銅箔基板廠